深圳市江波龙电子股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号: 2025-028

编号: 2025-028	
投资者关系活动 类别	√特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访□业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动□现场参观 ✓电话会议 □其他
参与单位名称及人员姓名	富国基金、恒越基金、东北证券、国信证券、巴克莱
时间	2025年10月30日(周四)下午15:00-16:00 2025年10月30日(周四)下午16:00-17:30 2025年10月31日(周五)上午10:00-11:30 2025年10月31日(周五)下午17:00-18:00
地点	深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059 号鸿荣源前海金融中心二期 B 座 2301
上市公司接待人 员姓名	副总经理、董事会秘书 许刚翎 投资者关系经理 黄琦 投资者关系资深主管 苏阳春
投资者关系活动主要内容介绍	1、如何看待存储涨价的幅度? 答:根据 CFM 闪存市场公布的信息,随着北美云服务商持续加码 AI 投资,大规模 AI 基础设施建设落地,HDD 供应已难以满足巨量数据存储需求,预计 HDD 将持续缺货并出现明显的供应缺口;云服务商纷纷追加大容量 QLC SSD 订单,导致服务器市场需求远超原厂原先的供应预期;原厂产能转向服务器市场,导致消费级及嵌入式存储供应收紧。根据

CFM 闪存市场报道,9月至10月下旬,现货市场512Gb TLC/1Tb TLC/QLC NAND 普遍价格累计涨超近40%。

2、晶圆涨价将如何影响公司的利润水平?

答:晶圆采购至存储器销售的生产周期间隔,决定了存储晶圆价格上行时对公司毛利率将产生正面影响,但原材料价格波动仅为业绩结果的部分因素。近年来公司在企业级存储、高端消费类存储、海外业务以及自研主控芯片等方面持续取得突破,内生性成长因素将更直接且持续地驱动公司盈利能力的提升。

3、如果存储供应出现短缺,公司如何保障资源供应稳 定性?

答:公司作为全球领先的独立存储器厂商,存货周转效率处于行业内较为优秀的水平,也具备理解及运用不同原厂生产的存储晶圆的能力,与全球主要存储晶圆原厂建立了长期紧密的伙伴关系。公司已经与晶圆供应商签有长期合约(LTA)或商业备忘录(MOU),在此框架内与晶圆原厂开展长期直接合作,供应链具备较强韧性,且较为多元。

4、如何看待公司企业级存储业务增速?

答:公司在自有核心知识产权、技术能力的基础上,积极参与大客户技术及新产品标案,头部客户与战略客户覆盖范围持续扩大。根据 IDC 数据,2025年上半年中国企业级SATA SSD 总容量排名中,公司位列第三,在国产品牌中位列第一。除此之外,公司 RDIMM 产品也已经批量出货,规模稳步扩大。同时,公司其他形态的企业级存储产品正在有序导入国内头部企业。

公司积极布局数据中心应用领域的高性能存储产品,拓展 CXL2.0、MRDIMM 等多种新型内存,并正式发布 SOCAMM2。 SOCAMM2 是专为 AI 数据中心设计的内存产品,在带宽、功耗上具有突破性表现,能够全面突破传统 RDIMM 的性能瓶颈 及高温痛点。根据公开报道,英伟达已开始与三星电子、SK 海力士、美光合作,对新一代 SOCAMM 类产品进行样品测试。 公司 SOCAMM2 产品目前尚未形成收入,请各位投资者注意风 险。

5、公司 UFS4.1 目前的进展情况如何?公司未来会在高端嵌入式领域取得多大的业务规模?

答:全球目前仅少数企业具备在芯片层面开发 UFS4.1 产品的能力,公司凭借自研主控芯片成功实现 UFS4.1 产品的能力,公司凭借自研主控芯片成功实现 UFS4.1 产品的突破。经原厂及第三方测试验证,搭载公司自研主控的UFS4.1 产品在制程、读写速度以及稳定性上优于市场可比产品,在获得以闪迪为代表的存储原厂认可的基础上,还获得多家 Tier1 大客户的认可,相关导入工作正加速进行。UFS4.1 作为当前嵌入式存储领域的高端产品,是 Tier1 大客户的旗舰智能终端机型的首选存储配置,伴随嵌入式存储市场由 eMMC 向 UFS 加速演进,整体市场高度集中且具备广阔空间。

6、公司主控芯片的应用规划?

答:存储主控芯片是存储器的"大脑",在多个层面上对存储器的整体性能表现起到了关键作用。目前公司已推出4个系列的多款主控芯片,采用领先于主流产品的头部Foundry工艺,采用自研核心IP,搭配公司自研固件算法,使得公司各类存储产品具有明显的性能和功耗优势。截至三季度末,公司自研主控芯片累计部署量突破1亿颗,并且部署规模仍在保持快速增长。搭载公司自研主控的UFS4.1产品正处于多家Tier1厂商的导入验证阶段,全年来看,自研主控芯片部署规模将实现放量增长。

关于本次活动是 否涉及应披露重 大信息的说明

本次活动不涉及未公开披露的重大信息。

|--|